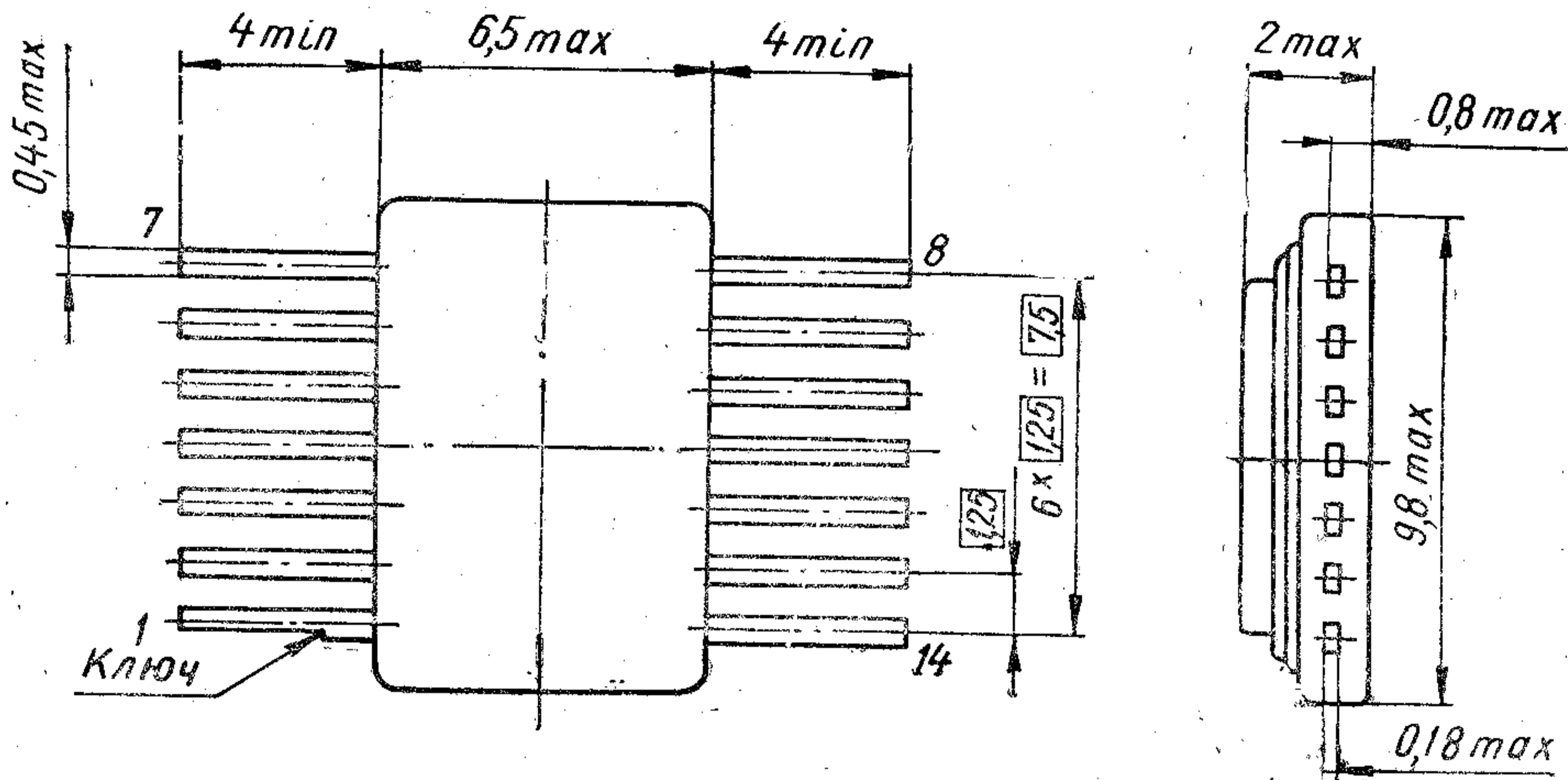


# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 104 (К104)

## Общие данные

Микросхемы выполнены в прямоугольном металлокерамическом корпусе.

### ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



Масса — не более 0,35 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

# МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 104(К104)

## Общие данные

### НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка $\circ$ . . . . .	10 000 ч
Срок сохраняемости $\circ$ для микросхем серии:	
104 . . . . .	12 лет
К104 . . . . .	6,5 лет

### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с требованиями, изложенными ниже.

При монтаже микросхемы устанавливаются на печатные платы. Не допускается перегиб выводов на инструменте с острыми краями и изгиб выводов на расстоянии менее 1,5 мм от корпуса до центра окружности изгиба. Радиус изгиба — не менее 0,4 мм.

Лужение выводов следует производить двукратным погружением в расплавленный припой при температуре 265° С в течение 2—3 с. Расстояние от корпуса до зеркала припоя — не менее 1,5 мм.

Перед лужением выводы микросхем предварительно обезжиривают в ванне со спиртом в течение 10—15 с, затем просушивают в течение 4—6 мин при температуре 25±5° С.

Монтаж микросхем следует производить только в обесточенном состоянии.

Пайку выводов допускается производить одножальным заземленным паяльником с температурой не более 250° С в течение 3 с, интервал между пайками — не менее 3 с, или групповым паяльником с температурой расплавленного припоя не более 250° С в течение 2 с, интервал между пайками — не менее 5 мин.

Расстояние от корпуса до места пайки — не менее 1 мм. При пайке выводов необходимо осуществлять теплоотвод между корпусом схемы и местом пайки, не допускается нагрев корпуса микросхемы более 120° С.

Рекомендуется применять припой ПОС-61 по ОСТ 11 029.001—74 и флюс (20% канифоли и 80% спирта).

Для влагозащиты микросхем следует применять лак УР-231 по МРТУ 6-10-863—69 или Э-4100 по МРТУ 6-10-857—69. Допускается промывка микросхем спиртом или другими веществами, не имеющими кислотных и щелочных свойств и не содержащими механических напряжений, приводящих к разрушению корпуса схемы и маркировки. Запрещается подведение каких-либо электрических сигналов и напряжения питания к выводам микросхем, не используемым согласно принципиальной электрической схеме, а также соединение этих выводов с корпусом аппаратуры.

Запрещается эксплуатация микросхем в режимах, превышающих предельно допустимые.

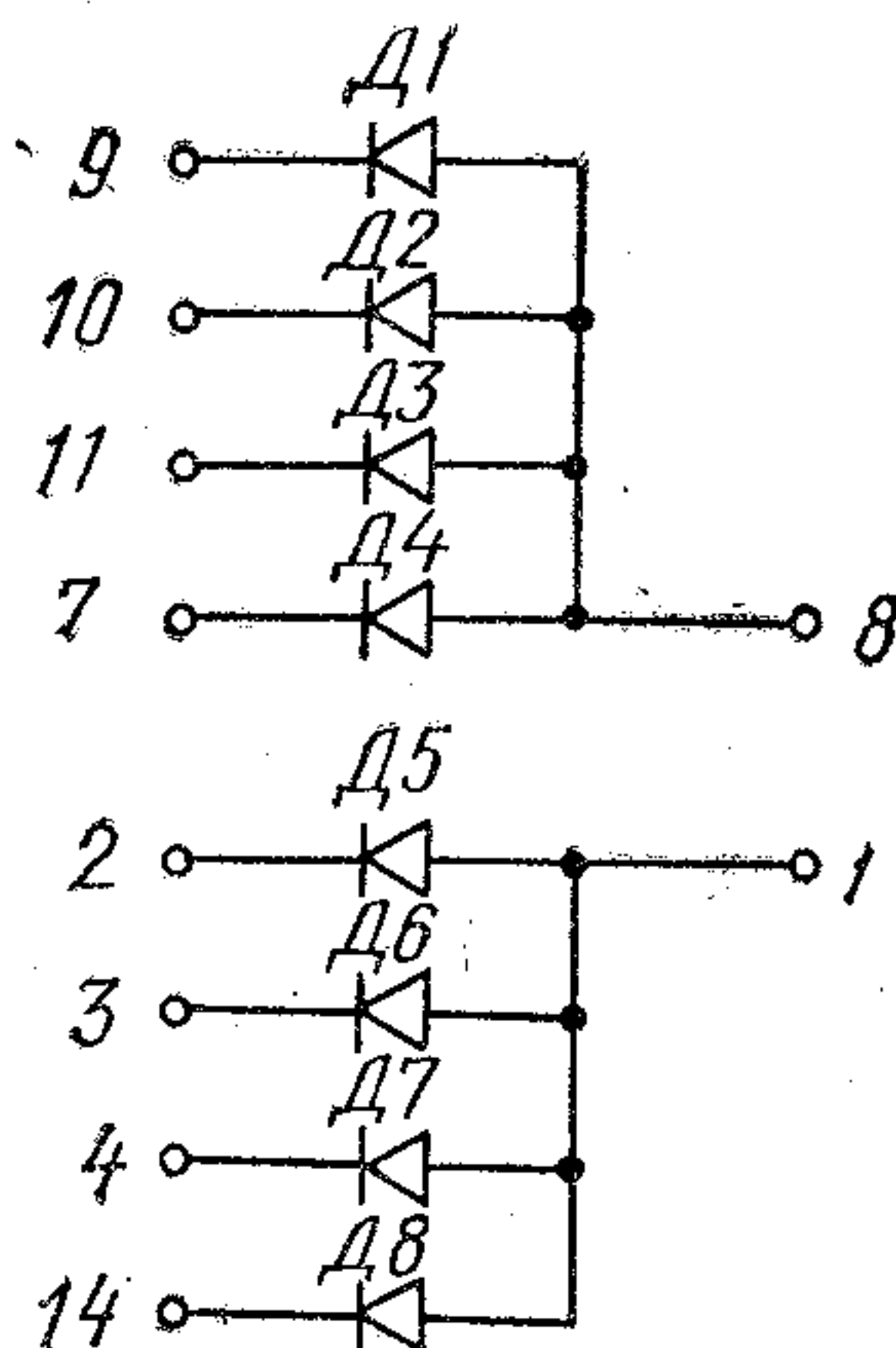
$\circ$  В условиях и режимах, допускаемых ОТУ, ЧТУ или ТУ.

# ДИОДНАЯ СБОРКА

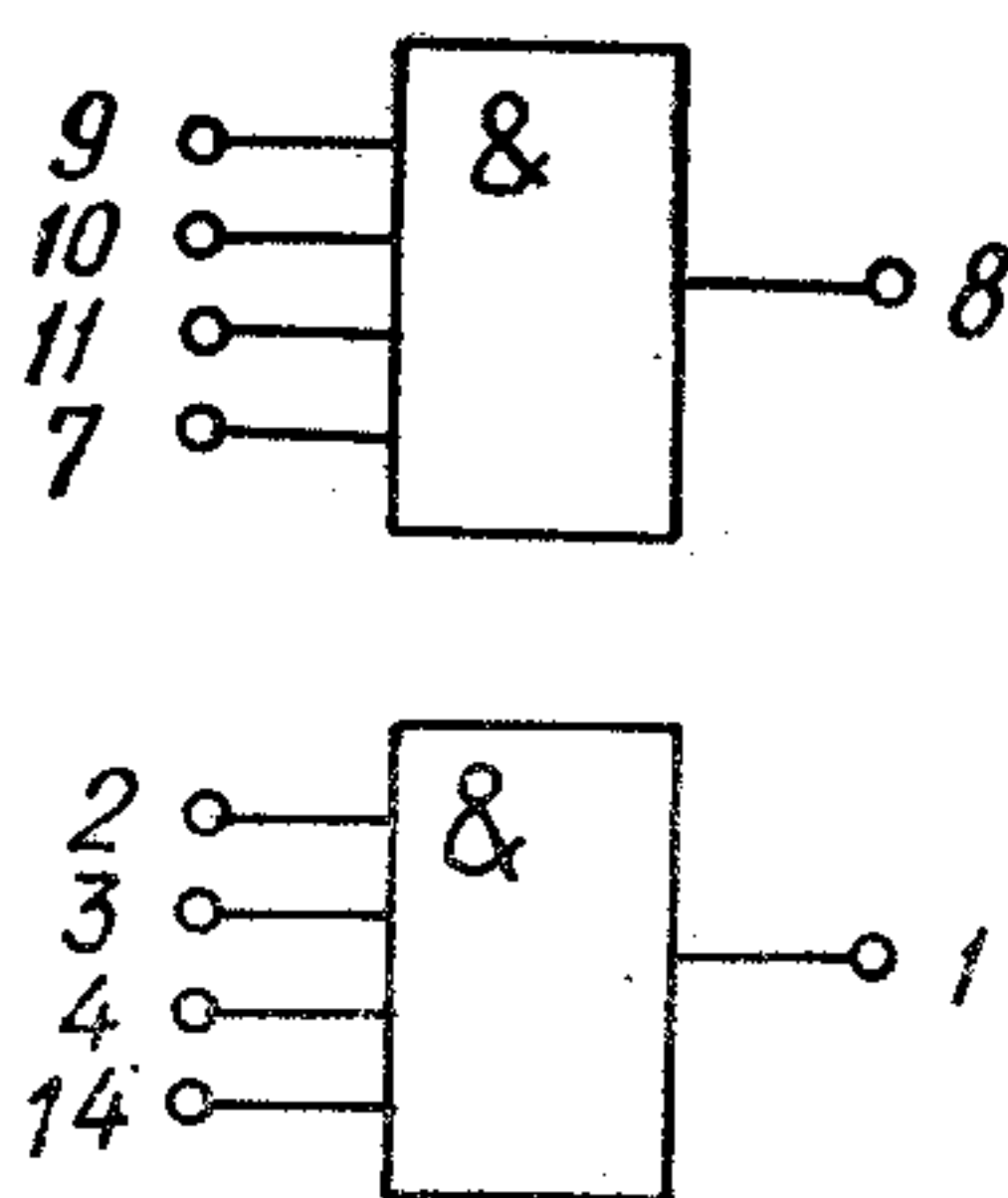
1НД041	К1НД041
1НД042	К1НД042
1НД043	К1НД043
1НД044	К1НД044

## ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА

1НД044 (К1НД044)



## ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



Микросхемы 1НД041 (К1НД041) не имеют входов 2—4, 7, 14.

Микросхемы 1НД042 (К1НД042) не имеют входов 2—4, 14.

Микросхемы 1НД043 (К1НД043) не имеют входов 7, 14.

1НД041	К1НД041
1НД042	К1НД042
1НД043	К1НД043
1НД044	К1НД044

## ДИОДНАЯ СБОРКА

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (при температуре $25 \pm 10^\circ \text{C}$ )

Прямое падение напряжения на входных диодах  
для микросхем:

1НД041—1НД044 . . . . .	от 0,60 до 0,85 В
К1НД041—К1НД044 . . . . .	от 0,55 до 0,90 В

Обратный ток входных диодов при  $U_{\text{обр}} = 4,5 \text{ В}$   
для микросхем:

1НД041—1НД044 . . . . .	не более 10 мкА
К1НД041—К1НД044 . . . . .	не более 12 мкА